

深圳市龙图光罩股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：龙图光罩

证券代码：688721

编号：2025-006

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	摩根士丹利、景顺长城、天风证券、国投瑞银、国源信达、浙江益恒、溪牛投资、民沣证券
时间	2025 年 9 月 3 日星期三下午 13:30
地点	深圳市福田区香格里拉大酒店
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书：邓少华 2、证券事务代表：李建东 3、证券法务专员：丁子善
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况 深圳市龙图光罩股份有限公司成立于 2010 年，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模板厂商，主营业务为半导体掩模板的研发、生产和销售。 自 2024 年 8 月公司完成科创板挂牌上市以来，公司不断增加投入进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模板工艺能力从 130nm 逐步提升至 65nm，并已完成 40nm 工艺节点的生产设备布局，产品广泛应用于信号链及电源管理 IC 等成熟制程，以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺制程。公司于 2022 年 8 月设立珠海市龙图光罩科技有限公司，紧随国家半导体行业发展战略，围绕高端半导体芯片掩模板领域持续加大研发投入，逐步实现高端制程的国产化配套，成为国内一流、国际领先的半导体光罩标杆企业。 二、投资者互动交流 1、公司设备的国产化程度如何？在上游供应链方面有何策略？ 回复：目前，公司的高端光刻机和检测设备仍主要依赖进口，这与当前半导体产业高端制造领域的普遍现状一致。公司深知供应链自主可控的重要性，并始终积极支持和推动国产化设备使用的进程。目前的策略是在保障当前生产稳定性和产品良率的前提下，审慎评估、

	验证并逐步引入合格的国产设备。在上游材料方面，公司也将供应链国产化作为核心战略之一，积极响应国家半导体产业自主可控政策导向，在保障产品性能与良率的前提下，通过合作开发、订单支持等方式支持国产材料厂商发展。 2、近期首台国产电子台光刻机“羲之”在杭州正式量产下线，其 0.6nm 的精度引发了市场关注，这是否对公司业务发展构成利好？ 回复：公司管理层也密切关注到国产电子束光刻机“羲之”的技术突破，我们认为这对于中国半导体产业链的自主可控具有积极的战略意义，体现了国内在尖端装备领域的创新实力。公司乐见国内半导体装备技术的任何进步，并认为“羲之”的下线是国产化进程中的重要一步，但其当前的技术特点决定了其对公司主营的掩模板业务短期直接拉动有限。公司将持续关注其技术发展和产业化应用进度，特别是其在高端掩模板制造环节的应用情况。公司始终致力于通过自身的技术迭代和产能建设，抓住国产替代的长期机遇。 3、目前半导体掩模板行业竞争愈发激烈，公司近年对此的发展战略是什么？ 回复：公司充分认识到当前市场竞争的加剧以及行业“内卷”化的态势。我们认为，这是国内半导体产业蓬勃发展和国产替代进程深入的必然阶段。面对挑战，公司已制定了明确的发展战略，将以“高端制程突破”和“客户结构升级”为双引擎，通过积极的产能布局、技术研发和市场拓展来应对竞争。随着珠海新产能的逐步释放和高端产品的占比提升，明年将是公司实现规模跨越和竞争力跃升的关键一年。 4、珠海一期工厂目前项目进展如何，产能爬坡周期的预计需要多少时间？ 回复：2025 年上半年，龙图光罩珠海项目顺利投产，公司第三代掩模板 PSM 产品取得显著进展。公司 KrF-PSM 和 ArF-PSM 陆续送往部分客户进行测试验证，其中 90nm 节点产品已成功完成从研发到量产的跨越，65nm 产品已开始送样验证，已完成 40nm 生产设备的布局，公司在高端制程的影响力进一步增强，覆盖的下游领域更加丰富。该项目年规划产能 1.8 万片，预计达产后产值 5.4 亿元。珠海公司二季度已开始小规模量产，预计 2025 年下半年开始将逐步放量。 5、公司珠海高端半导体芯片掩模板制造基地二期工程的当前建设进展如何？该项目是否存在相应的融
--	--

	资需求？具体的融资计划是怎样的？ 回复：珠海二期工程目前正在按计划顺利推进中，主体厂房预计将于 2025 年 9 月完成封顶，作为公司实现高端制程突破和产能扩张的战略性项目，且考虑到公司目前资产负债率尚处于较低水平，未来将考虑通过债权和股权融资等方式筹集资金。届时公司将根据资本市场环境、监管政策以及公司自身财务状况，审慎决策并选择最有利于公司和全体股东的融资方案，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。 6、随着半导体芯片先进封装市场的快速增长，公司在战略层面是否进行了相应调整？如何看待先进封装业务对公司未来营收的贡献？ 回复：先进封装技术是超越摩尔定律、提升芯片性能与集成度的关键路径，其对多层级、高密度互连的需求，催生了高精度掩模板的新需求。2025 年上半年，公司持续将市场与技术资源向先进封装领域倾斜，成功开拓了包括天成先进在内的新封装客户，并进一步加深了与华天科技等现有知名封装厂商的战略合作。我们将继续深耕这一市场，提升在先进封装领域的市场份额和品牌影响力。 7、公司的掩模板产品在新能源汽车和机器人领域有哪些具体应用？公司如何看待这些新兴市场带来的机遇？ 回复：公司高度关注新能源汽车和机器人等快速发展的新兴市场，并积极跟进其技术发展趋势所带来的掩模板需求。具体而言，公司的掩模板产品主要用于 IC 制造、IC 器件、IC 封装、MEMS（微型传感器）、光电子等多个领域。这些基础产品是新能源汽车和机器人产业不可或缺的核心组成部分：掩模板作为其内部核心电子元件生产过程中的关键工具，其技术水平和供应能力对这些终端产业的发展起着重要的支撑和推动作用。 随着新能源汽车智能化程度的不断提升和机器人技术的持续演进，其对高性能、高可靠性芯片和元器件的需求将持续增长，这将为掩模板行业带来新的增长空间，公司将持续关注这些下游领域的技术变革，积极进行相应的技术开发和市场开拓，以抓住市场机遇。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 3 日星期三